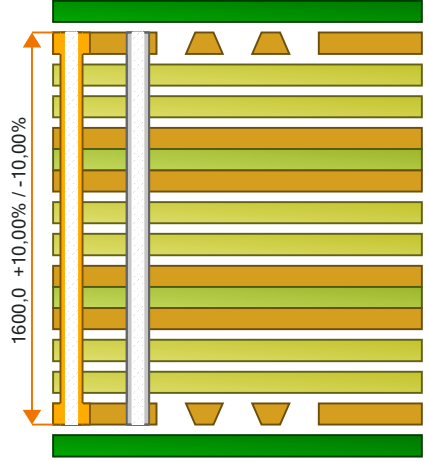






Lage	Lagenaufbau	Impedanz ID	Isolation Distance (Summed)	Aufkopperungsdicke	ϵ_r	Type	Tg
					3,70		
1		1, 2		38,00		JTC, HTE	
			208,63	110,00	4,60	2116	150,00
			-	110,00	4,60	2116	150,00
2				35,00			
			360,00	360,00	4,60	Dielektrikum	150,00
3				35,00			
			172,89	110,00	4,60	2116	150,00
			-	110,00	4,60	2116	150,00
4				35,00			
			360,00	360,00	4,60	Dielektrikum	150,00
5				35,00			
			208,63	110,00	4,60	2116	150,00
			-	110,00	4,60	2116	150,00
6		3		38,00		JTC, HTE	
					3,70		

Kupferdicke = 216,000 | Dicke Dielektrikum = 1310,140 | Dicke Lötstopmmaske = 80,000 | Lagenaufbau-Gesamtdicke = 1526,140 | Lagenaufbaudicke mit Lötstopmmaske = 1606,140

Strukturbild	Impedanz ID	Struktur-Name	Impedanz Signallage	Ref. Lage 1 in Lage	Zielimpedanz	berechnete Impedanz	Error %	Untere Leiterbreite (W1)	Leiterbahn-Separation (S1)
	1	Edge Coupled Coated Microstrip 1B	1	2	100,00	100,00	0,0	160,00	145,00
	2	Edge Coupled Coated Microstrip 1B	1	2	90,00	89,59	0,5	226,00	155,00
	3	Diff Coated Coplanar Waveguide With Lower Ground 1B	6	5	90,00	90,37	0,4	220,00	161,00

Hinweise

Aufbau-Name: Master	Version:	Revision:	Modifikation:	Änderungsdatum:	Editor	Seite 1/1	
Datum:	Weitere Dokumente:						
Autor:							
Abteilung:							
Standort:							